



360iC 安芯易

2025年10月异常物料拦截报告

安芯易品控中心

绝不让一颗假货流向客户

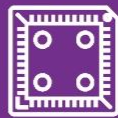
深港两大品控中心



安芯易于深圳、香港两地设立了专业的品质控制中心，占地超2000m²，配备100+功能广泛的实验室设备，并汇聚了一支行业资深的专业质量检测团队。品控中心依据 ISO17025 等国际标准管理系统运行，我们坚守“**绝不让一颗假货流向客户**”的质量承诺，通过全面的质量管理和专业的检测流程，致力于为客户的元器件供应链安全保驾护航。



占地超
2000m²



100+功能广泛
的实验室设备



专业
质量检测团队



富士康
战略合作



ISO9001
ISO27001
ISO14001
资质认证



AS 6180
AS 9120B
资质认证

质量检验流程

四大优势

严谨

- 初验、复审、终审
- 100%拦截旧货，假货和翻新货

高效

- 最快1小时完成检测流程
- 最快2小时获得检测报告

规范

- 依据ISO14001、ISO9001、ISO27001、AS9120B等国际标准管理体系运行

专业

- 专业质量检测团队
- 100+功能广泛的实验室设备

四级检测流程

01



标签验证

02

本体外观、
丝印检测

03

功能、
可靠性检测

04



委外检测

品控设备展示

阻抗分析仪



半导体分立器件
静态参数测试系统



数字万用表



精密LCR测试仪



X-RAY



马弗炉



X射线荧光分析仪



高温实验箱



超声波SAM



光学数码显微镜



景深显微镜



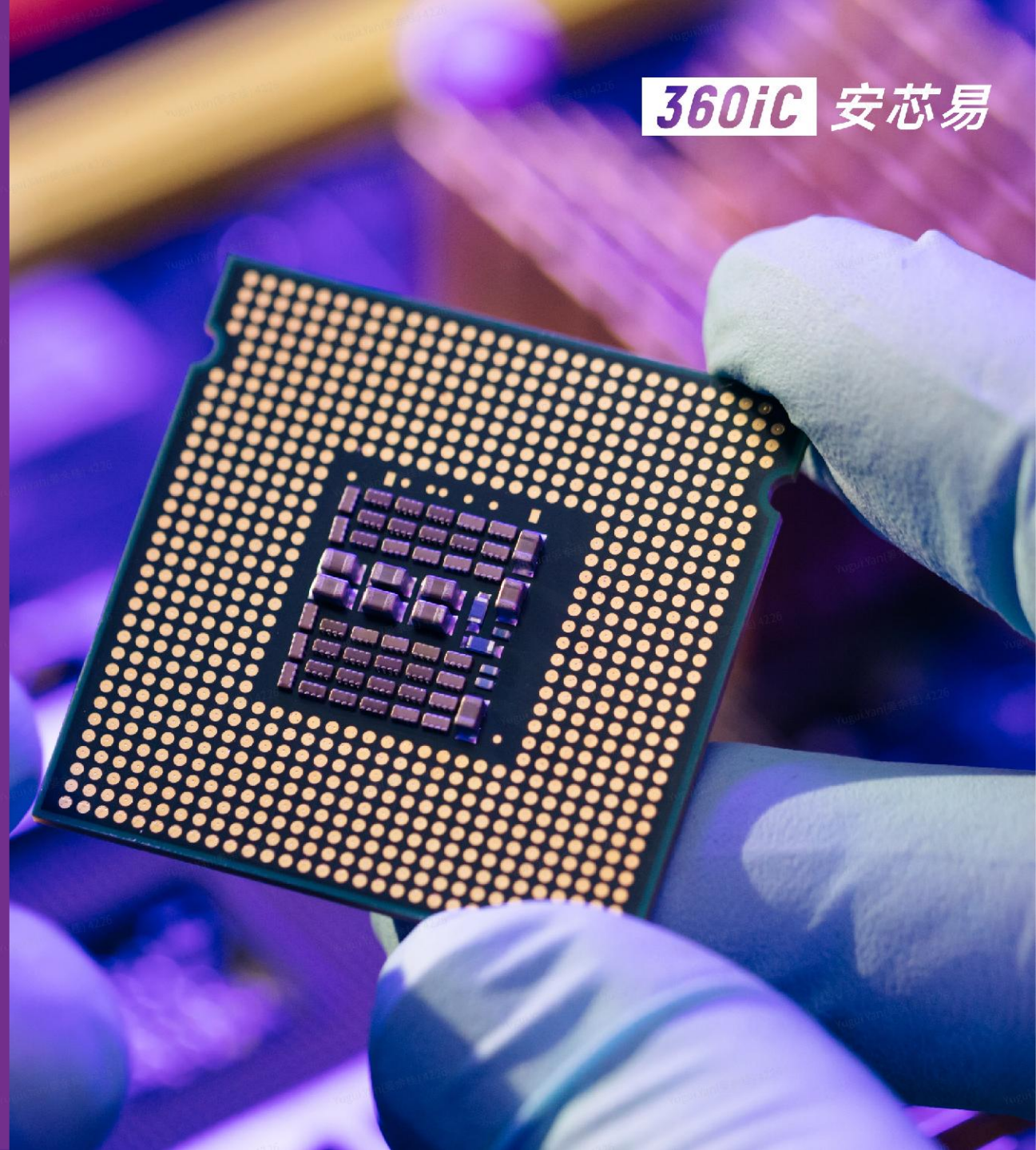
半导体测试系统



01. 一级检测拦截汇总

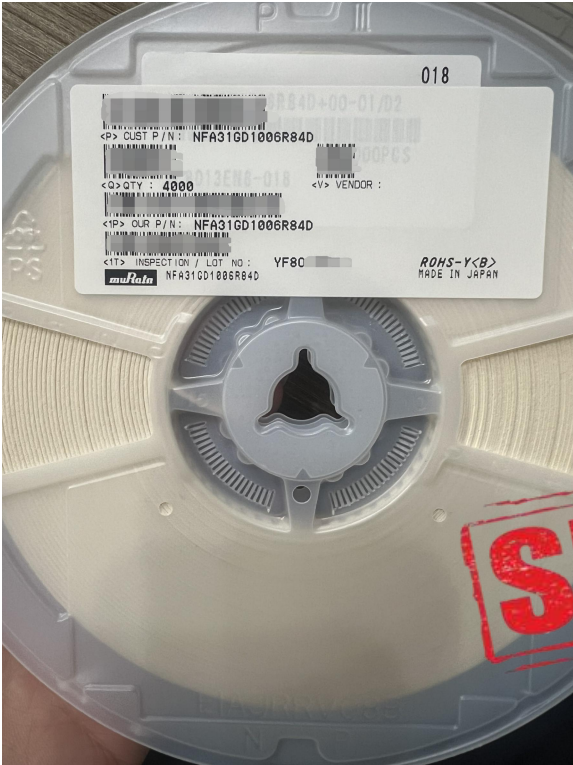
一级检测：将货品标签和包装与安芯易标签数据库中的原厂标签和包装进行对比，专业的标签验证可以拦截90%的假冒器件。

注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



1.1 MURATA

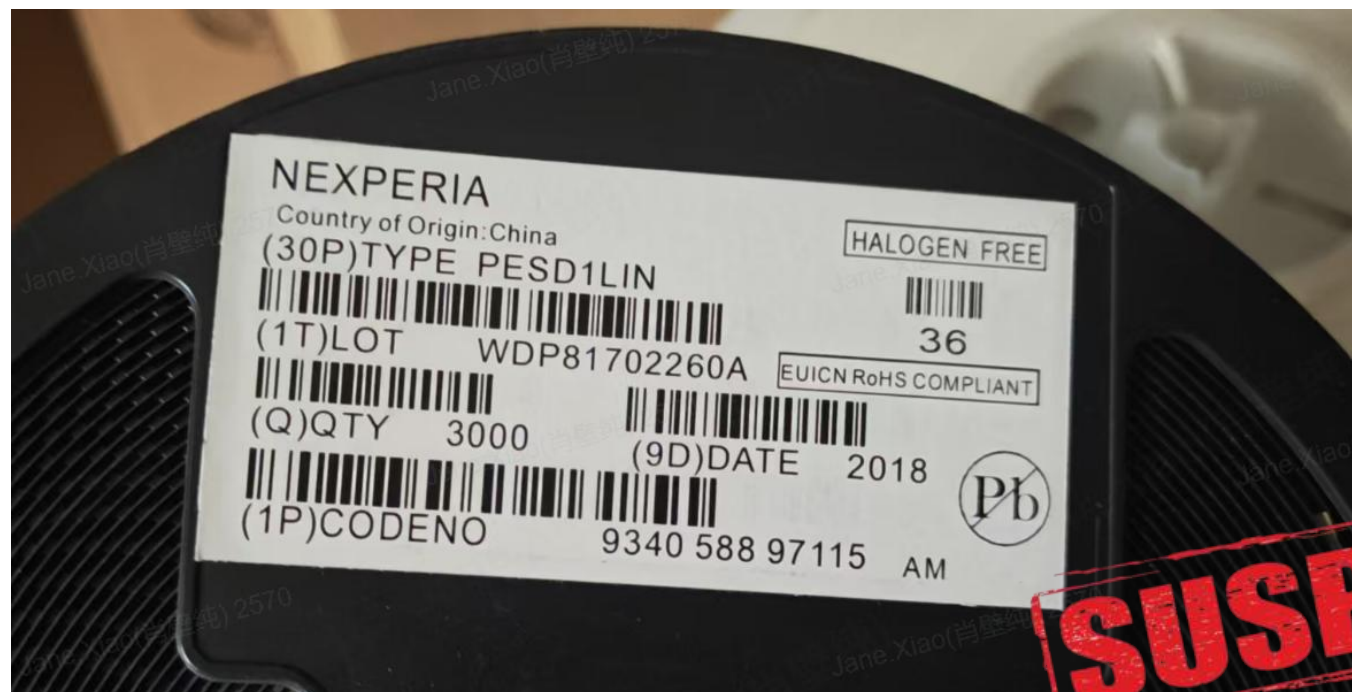
高风险来料			
型号	品牌	产地	日期代码
NFA31GD1006R84D	MURATA	日本	/



1.2 NEXPERIA

高风险来料

型号	品牌	产地	日期代码
PESD1LIN	NEXPERIA	中国	2018



1.3 NEXPERIA

高风险来料

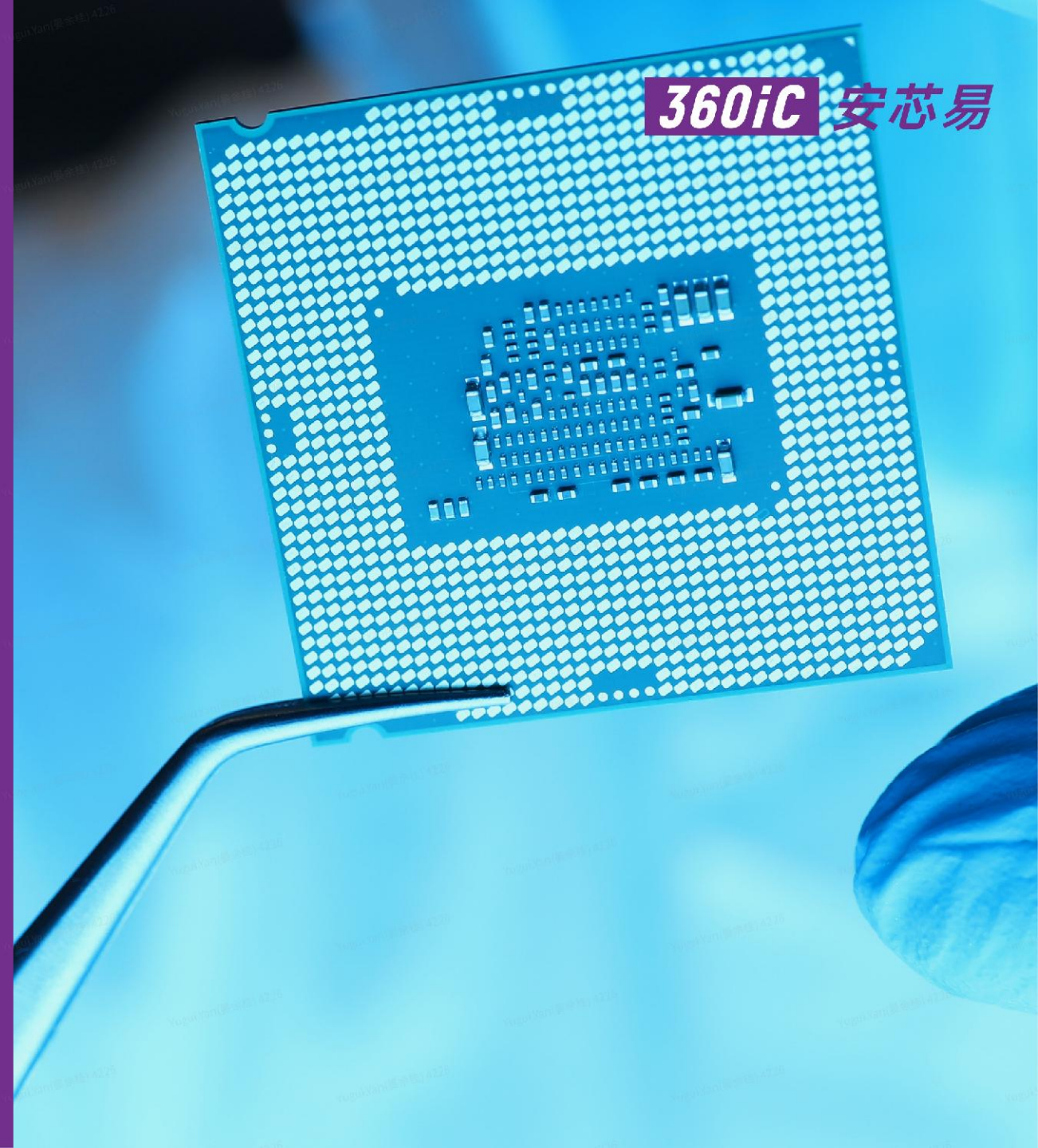
型号	品牌	产地	日期代码
PESD1LIN	NEXPERIA	中国	2443



02. 二级检测拦截汇总

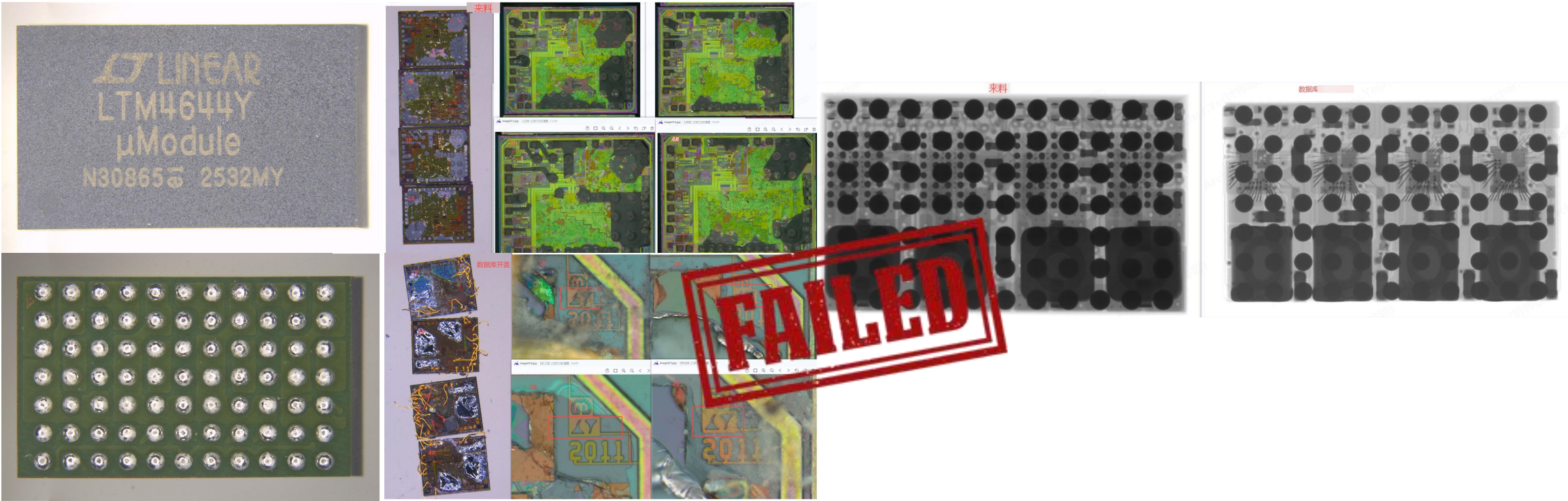
二级检测：即本体外观、丝印检验，通过放大倍数高达160倍LEICA体视显微镜，检查每个器件的模封体正反面、引脚、BGA球、定孔位、模体号等，通过外观检测能100%拦截旧货和翻新货。

注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



2.1 ADI

高风险来料			
型号	品牌	产地	日期代码
LTM4644IY#PBF	ADI	马来西亚	2532



2.2 GREENLIANT

高风险来料

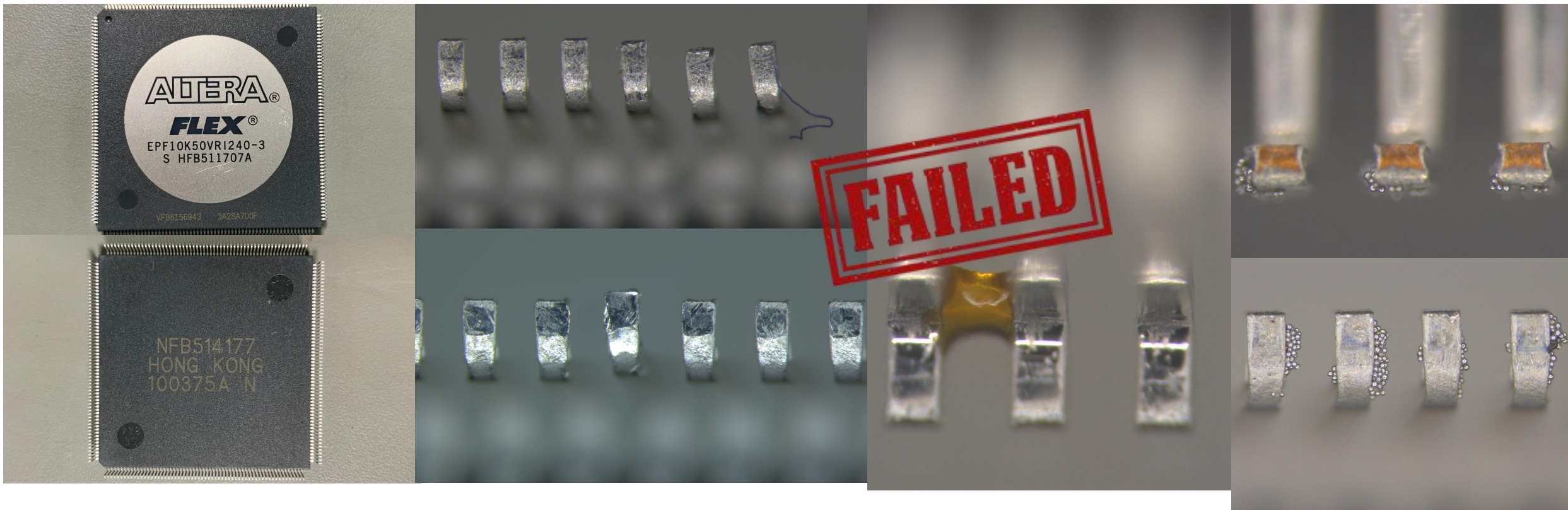
型号	品牌	产地	日期代码
GLS85LS1032P-S-I-FZJE-TT095	GREENLIANT	/	17+



2.3 INTEL

高风险来料

型号	品牌	产地	日期代码
EPF10K50VRI240-3	INTEL	中国香港	1707



2.4 ISOCOM

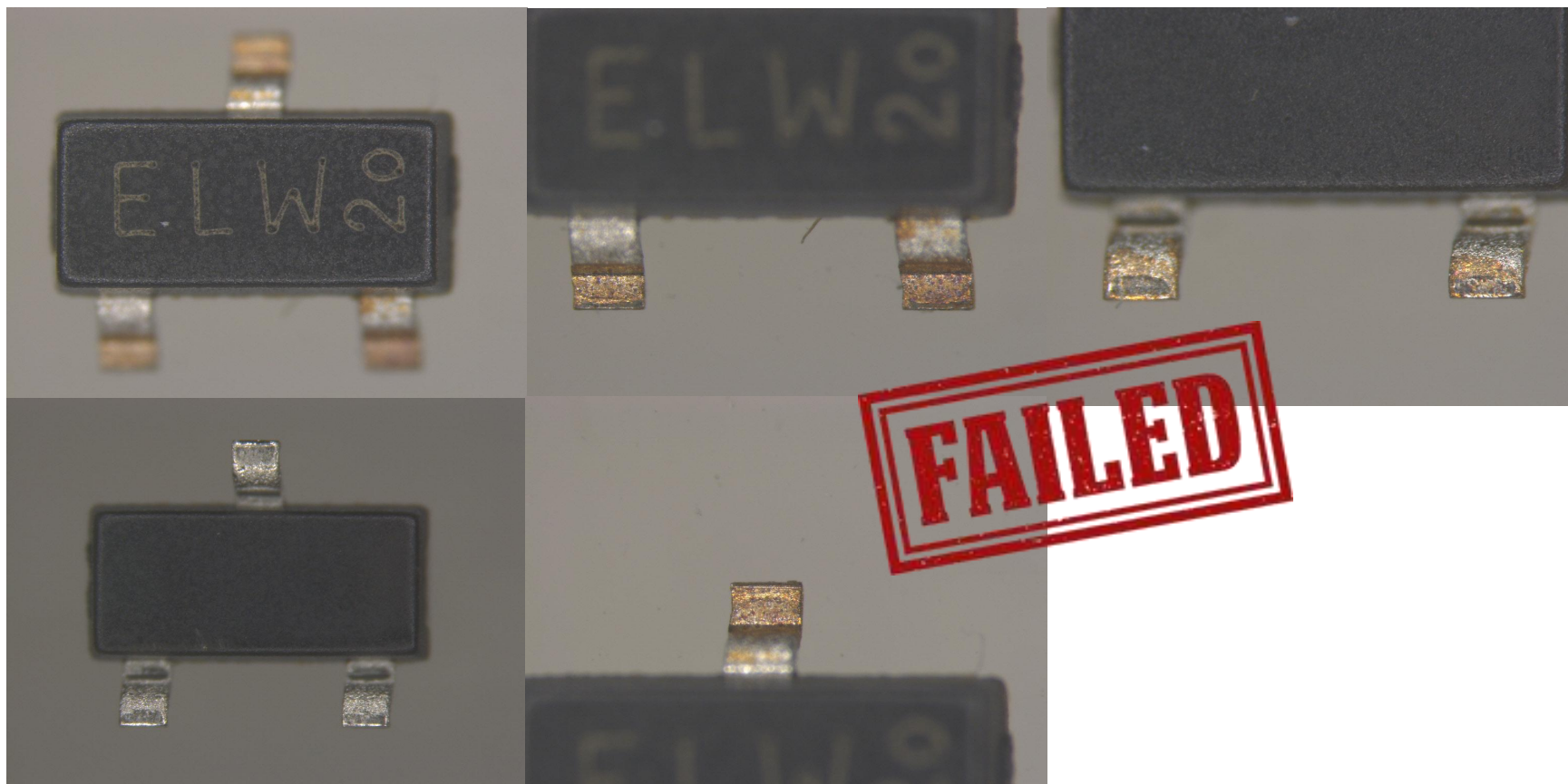
高风险来料			
型号	品牌	产地	日期代码
H11L1SMT&R	ISOCOM	中国台湾	2139



2.5 NEXPERIA

高风险来料

型号	品牌	产地	日期代码
PMV280ENEAR	NEXPERIA	中国	2243



2.6 NEXPERIA

高风险来料

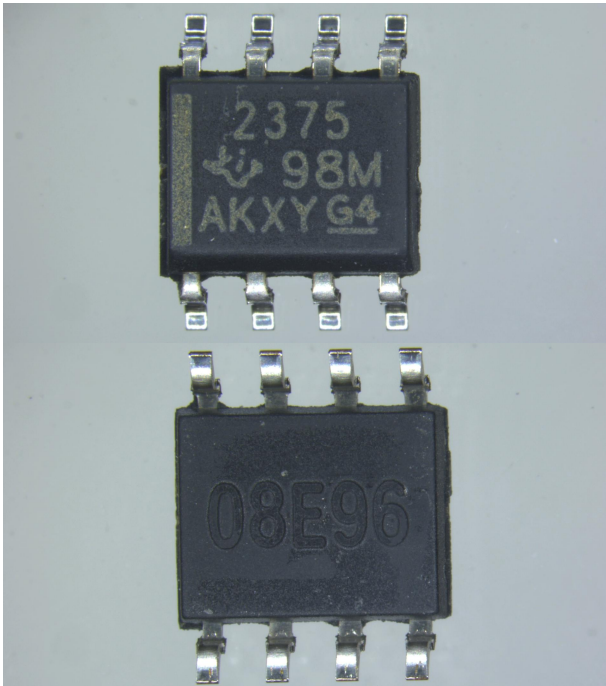
型号	品牌	产地	日期代码
BZX84J-C16	NEXPERIA	中国	1831



2.7 TI

高风险来料

型号	品牌	产地	日期代码
TPS2375DR	TI	/	2500



PCN Number:	20180322004	Notification Date:	April 20, 2018
Title:	Top-side symbol font change for Selected Device(s)		
Customer Contact:	PCN Manager	Dept:	Quality Services
Change Type:	☐ Assembly Site ☐ Assembly Process ☐ Assembly Materials ☒ Mechanical Specification ☒ Packing/Shipping/Labeling		
	☐ Design ☐ Data Sheet ☐ Part number change ☐ Test Site ☐ Test Process	☐ Wafer Bump Site ☐ Wafer Bump Material ☐ Wafer Bump Process ☐ Wafer Fab Site ☐ Wafer Fab Materials ☐ Wafer Fab Process	
PCN Details			
Description of Change:			
Texas Instruments is pleased to announce a Top side symbol font change from Standard Font to OCR-A (Optical Character Recognition) Font type for the affected devices. Symbolization sample comparison are as follows:			
	Current Standard Font	Proposed OCR-A Font	
Reason for Change:			
Improve optical recognition during Auto Visual Inspection (AVI) and align with ISO 1073-1:1976 standard			
Anticipated impact on Fit, Form, Function, Quality or Reliability (positive / negative):			
None			
Anticipated impact on Material Declaration:			

谢谢观看

THANKS

安芯易电子商务（深圳）有限公司

深圳市福田区华富路1018号中航中心34层 0755-83289263 marketing@360ic.com <http://www.360ic.com>

360ic 安芯易

温馨提示：此文档知识产权
归属于安芯易电子商务（深
圳）有限公司，未经本公司
许可，任何单位和个人不得
擅自转载。

